



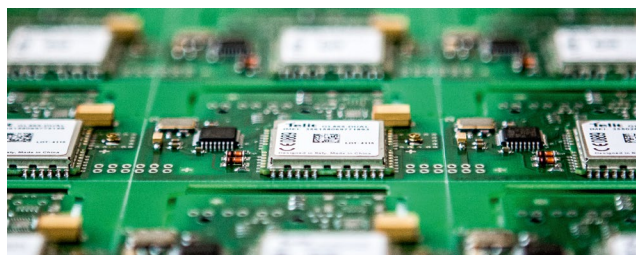
Produkcja płytek i montaż SMT / THT

O FIRMIE

BaZeKo istnieje od 1986 roku i zajmuje się produkcją seryjną i prototypową obwodów drukowanych oraz montażem SMT i THT. Działalność firmy rozpoczęła się na terenie Łodzi, ale bardzo szybko zasięg naszych działań rozszerzył się na cały kraj i zagranicę. Oferujemy również kompleksowe przygotowanie produktów wraz z testami funkcjonalnymi oraz finalnym pakowaniem.

Systematyczne poszerzanie naszych możliwości produkcyjnych oraz ciągłe doskonalenie jakości wykonania dają pełną gwarancję spełnienia rosnących potrzeb klientów naszej firmy. Z naszych usług korzystają firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Danii, USA, Ukrainy oraz Białorusi. Od wielu lat współpracujemy ściśle również z Politechniką Łódzką.

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy wyłącznie produkty sprawdzonych i renomowanych firm. Większość materiałów sprowadzamy sami bezpośrednio od producentów, polegając na ich



zaleceniach i wsparciu technologicznym. Dlatego też możemy zaoferować naszym klientom wyroby najwyższej jakości.

Nasi pracownicy odbywają regularnie szkolenia w zakresie norm:

- IPC-A-600H CIS – kryteria dopuszczalności płyt drukowanych,
- IPC-A-610E CIS – standard jakości montażu układów elektronicznych,
- IPC-7711B/7721B CIS – naprawa i modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt drukowanych (pełny zakres normy).

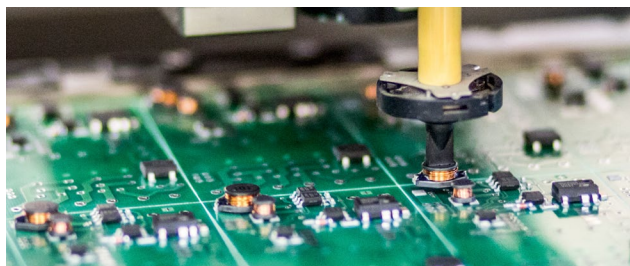
Ponadto mamy wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji i montażu płytek obwodów drukowanych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Od początku roku 2017 realizujemy konsekwentnie proces inwestycji związanych z kolejnym unowocześnieniem naszego parku maszynowego, kładąc szczególny nacisk na aspekt miniaturyzacji produktu finalnego i jego jakości.

OFERTA

W zakresie płytek obwodów drukowanych oferujemy:

- obwody drukowane jednostronne i dwustronne
- obwody drukowane na podłożu metalowym AICu
- obwody drukowane na podłożu teflonowym
- wiercenie i frezowanie
- metalizacja chemiczna i galwaniczna
- nanoszenie masek przeciwłutowniczych
- nanoszenie maski zdzieralnej
- nanoszenie opisów montażowych
- złocenie
- cynowanie metodą HASL



- nacinanie (V scoring)
- testowanie elektryczne i AOI
- płytki wielowarstwowe wykonane u podwykonawcy

Możliwości technologiczne:

- materiał: standardowo FR-4, IMS, laminaty teflonowe (TLC, RF-35)
- grubość laminatów: 0,5 mm ÷ 3,2 mm
- grubości miedzi: 18 μm ÷ 105 μm
- maksymalny wymiar formatki jednostronnej: 430×550 mm
- maksymalny wymiar formatki dwustronnej: 360×500 mm
- średnica wierconego otworu: od 0,30 mm
- min. szerokość ścieżki: 0,10 mm (4 mils)
- min. odstęp między ścieżkami: 0,10 mm (4 mils)
- kolory maski: zielona, niebieska, czerwona, czarna, biała, biała LED
- kolory opisu: biały, czarny
- pokrycie: cyna HAL, złoczenie chemiczne

W zakresie montażu:

- automatyczny montaż powierzchniowy SMT
- lutowanie rozplływowe
- montaż przewlekany (THT)
- lutowanie ręczne
- programowanie IC
- testowanie AOI
- kompletowanie elementów do stałych zleceń
- montaż końcowy urządzeń (mechaniczny)
- test elektryczny w oparciu na wyposażeniu Klienta
- test funkcjonalny w oparciu na wyposażeniu Klienta

Możliwości technologiczne:

- montaż jednostronny
- montaż dwustronny
- min. wielkość SMD: 1,00 mm × 0,5 mm (0402)
- max. wielkość SMD: 50 mm × 50 mm
- maksymalna wielkość formatki: 360×540
- stała kontrola temperatury lutowania na mikroprocesorowych stacjach lutowniczych
- elastyczność w przypadku dużych i małych partii
- atrakcyjne terminy
- końcowy montaż urządzeń wraz z pakowaniem

